

2025 年 11 月 14 日

報道関係者 各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
(コード：6920 東証プライム市場)
問合せ先 企画管理部 広報・IR 室長 花島 頼示
(TEL.045-478-7111)

新製品 超短パルスレーザー励起顕微鏡 OPTELICS UXM を発表

【概 要】

この度、レーザーテックは超短パルスレーザー励起顕微鏡 OPTELICS UXM を製品化いたしました。OPTELICS UXM はワイドバンドギャップ化合物半導体ウェハ(以下、WBG ウェハ)に存在する内部欠陥の三次元構造を非破壊で評価できる装置です。

【内 容】

当社は SiC、GaN をはじめとする WBG ウェハの検査需要に応えるソリューションをタイムリーに提供することで、世界中のウェハ・エピ・デバイスメーカーから高く評価いただいております。近年、WBG ウェハの高品質化が進む中で、欠陥の詳細な形状やその発生原因を評価、解析するツールの需要が高まっています。

このようなニーズに対応すべく、材料内部の欠陥を捉え、従来は破壊的手法でしか観察することのできなかった三次元構造を非破壊で観察可能な OPTELICS UXM を開発いたしました。内部欠陥構造の解析結果をプロセスにフィードバックすることで、WBG ウェハのプロセス改善、歩留まり向上に貢献いたします。

当社は量産工程の全数検査に対応したウェハ検査装置を幅広く提供することで、研究開発から量産まで、プロセス全体の歩留まり改善を支援しております。今後も WBG の課題に応じたソリューションを提供し、業界の技術革新と品質管理の高度化に貢献できるよう、継続的な価値創造に取り組んでまいります。

【特 長】

- ・ WBG ウェハ内部欠陥の三次元構造を非破壊で可視化
- ・ 電動 XY ステージ搭載による自動座標制御および各種検査装置との連携

【用 途】

- ・ WBG ウェハの貫通転位、基底面転位、積層欠陥など内部欠陥の構造解析
- ・ WBG ウェハおよび結晶の転位密度の非破壊評価



超短パルスレーザー励起顕微鏡 OPTELICS UXM

※装置画像は開発中のものです。製品の最終的な外観は変更となる可能性があります。

お問い合わせ先

〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社 技術六部 藤木 翔太
TEL:045-478-7337
E-mail: sales@lasertec.co.jp